

數字解密

TI 在猶他州Lehi的下一個12吋半導體晶圓廠

110
億美元投資

猶他州史上
最大 經濟投資

約 **800**
個新 TI 工作機會及
上千個間接工作

2023
年末開始建造

2026
年即可投入生產

每日將可製造 **數以千萬計** 的
類比與嵌入式處理晶片

設計符合 **LEED** 金級認證

回收水率為現有
晶圓廠將近 **2 倍**

將於 Alpine School 區投資 **9** 萬美元



我們將在猶他州Lehi
創造半導體製造業的新紀元

欲知詳情，請造訪 [TI.com/Lehi](https://ti.com/Lehi)